

K81 CuSn0.15 CW117C半导体芯片引线框架选材用材

产品名称	K81 CuSn0.15 CW117C半导体芯片引线框架选材用材
公司名称	深圳市鸿鑫百炼金属材料经营部
价格	98.00/千克
规格参数	型号:K81铜合金 规格:高导铜带 报告:原厂材质证明, SGS报告, 进口报关证明
公司地址	深圳市龙岗区龙岗街道南联社区环城南路
联系电话	15989359067 15989359067

产品详情

铜带C64775 (C7025-Sn)、 C12000(SW-Cu/Cu-DLP)/C1201/TP1、 C12200(SF-Cu/Cu-DHP)/C1220/TP2、 C10100(OF-Cu/Cu-OFE)/C1011/TU2、 C51100(CuSn4/C5110)、 C51000(CuSn5/C5100)、 C19002(CuNiSi)、 C70260(CuNi2Si)、 C19040(CuSn1.2Ni0.8P0.07/CAC5)、 C19025(NB109)、 C26000(CuZn30/C2600)、 C26800(CuZn33/C2680)、 C27200(CuZn37/C2720) CuFe10 (CFA90)、 CuFe5 (CFA95)、 C50710(CuSn2Ni0.3P/MF202)、 C50715(CuSn2Fe0.1P/KLF5)、 C15100(CuZr0.1)、 C19010(CuNiSi/STOL76)、 C18080(CuCrAgFeTiSi)、 C18070(CuCrSiTi)、 C18400/C18150(CuCrZr)、 C14415(CuSn0.15/C14410)、 C19400 (CuFe2P)、

C51100 (CuSn4)、 C70250(CuNi3Si)C11000(E-Cu/Cu-ETP/C1100/T2)、 C72700 (CuNi9Sn6)、 C72900 (CuNi15Sn8)、 Cu-01S、 Cu01、 FeNi42 (4J42/Nilo42)、

材料介绍：C14415 (CuSn0.15)

CuSn0,15 CW117C

C14415合金是一种低锡铜合金，比纯铜软化温度高，并具有良好的蠕变，应力松弛和抗疲劳性能。

材料特征：具有良好的耐腐蚀性并且没有应力开裂腐蚀。

材料在中等强度和良好导电性下具有良好的可成型性。热浸锡，焊接和电镀性能非常好。

标准：

DIN	EN	ASTM	JIS
CuSn0.15	CuSn0.15	C14415	C14410
	CW117C		

化学成分：

Cu + Sn	99.96
	0.1-0.15

物理特性：

密度（比重）（g/cm ³ ）	8.93
导电率 IACS（20）	85
弹性模量（KN/mm ² ）	130
热传导率W/(m*K)	350
热膨胀系数（10 ⁻⁶ /20/100/）	18

物理性能：

状态	抗拉强度 (Rm, MPa)	延伸率 A50	硬度 (HV)	弯曲试验 90°; (R/T)	
				GW	BW
R250	250-320	min9	60-90	0	0
R300	300-370	min4	85-110	0	0
R360	360-430	min3	105-130	0	0
R420	420-490	min2	120-140	1	1

材料应用：

连接器插针、工业电器部件、汽车用保险盒、半导体引线框架

质量认证：

电镀服务：

电镀项目	种类	镀层厚度 (um)	打底厚度 (um)	裸材厚度 (mm)
电镀锡Sn种类	亮锡	1.0-10.0	Ni/Cu 1.0-2.5	0.05-3

	雾锡	1.0-10.0	Ni/Cu 1.0-2.5	0.05-3
	回流镀锡	0.8-2.5	Cu < 1.5	0.1-1.0
	热浸镀锡 (Hot Dip Tin)	1.0-20.0	/	0.2-1.2
电镀镍Ni (雾、亮)	电镀镍	7.0max	Cu < 1.5	0.05-3.0
电镀银Ag	电镀银	0.5-2.0	Ni < 1.5	0.05-3.0
条镀金Au/银Ag	选镀金/银	0.5-2.0	Ni < 1.5	0.05-1.0